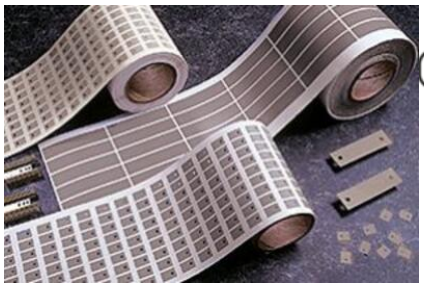
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SIL PAD TSP Q2000

Q-PAD® 3

SIL PAD TSP Q2000
Fiberglass-Reinforced, Silicone based, Grease Replacement Thermal Interface



- Lämpöimpedanssi: 0.35°C-in2/W (@50 psi)
- Poistaa tyypillisesti rasvan kanssa liittyvät käsittelyrajoitukset
- Muotoutuu pintatekstuuriin
- Helppo käsitellä
- Voidaan asentaa juottamisen ja puhdistuksen jälkeen

TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® SIL PAD TSP Q2000 poistaa ongelmat, jotka liittyvät lämpörasvaan, kuten elektronisten kokoonpanojen ja juotospesien saastumisen. BERGQUIST SIL PAD TSP Q2000 voidaan asentaa juottamisen ja puhdistuksen jälkeen huoletta.

Kun elastomeeri puristetaan kahden pinnan väliin, se muotoutuu pintatekstuuriin, luoden ilmarakottoman liitoksen lämmön tuottavien komponenttien ja jäähdytyssiilojen välille. Lasikuituvahvistus mahdollistaa BERGQUIST SIL PAD TSP Q2000:n käsittelyrasitukset menettämättä fyysistä eheyttään. Se tarjoaa myös helppokäyttöisyyttä soveltamisen aikana.